Leiterplattenspezifikation

Diese Leiterplattenspezifikation ist allgemein für alle Leiterplatten der Fa. Engelmann gültig und wird für jedes Projekt neu bewertet. Folgende Dokumente sind zusammen mit dieser Leiterplattenspezifikation zu pflegen.

* 0020600xx\_Lagenanordnung
* 0020600xx\_Lagenaufbau

# Gültigkeit

Diese Spezifikation für folgende Leiterplatten gültig

Leiterplatten: 0020600002 (SS3 Nachrüstbar)

0020600003 (SS3 Funkready)

0020600004 (SS3 Mbusready)

0020600010 (SS3 Modul Mbus)

0020600014 (SS3 Modul Radio)

0020100014 (SS2U-MID-Mbus2IE)

0020100015 (SS2U-MID-wMbus2IE)

**Hinweis für die Verwendung von ODB++ Daten:**

Systembedingt werden mehr Layer abgebildet als für die Fertigung nötig ist. Folgende Layer sind für die Fertigung zu berücksichtigen;

* Lötstop oben
* Oben
* GND
* VCC
* Unten
* Lötstop unten
* Bestückung unten (Bestückungsdruck)
* board
* Panel outline
* Panel V Score
* through hole

# Versionen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | Erstanlage | 19.01.2016 | WWA |
| V02 | Änderung IPC-Klasse von C auf B | 11.04.2016 | WWA |
| V03 | Änderung Endleiterplattendicke von 1,66mm auf 1,65mm nach Isola und einfügen von „Via mit Lötstopplack bedeckt“ und nicht geflutet | 02.05.2016 | WWA |
| V04 | Historie Tabelle eingefügt / Gültigkeit für Leiterplatten 00201000xx (SS2U\_MID-xxx) erweitert | 17.07.2016 | WWA |
| V05 | Hinzufügen Verwendung von ODB++ DAten | 19.09.2016 | WWA |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Technische Ausführung der Leiterplatte:

IPC – Klasse: Klasse B

Leiterplattenmaterial: FR4

Endleiterplattendicke: 1,65mm ±10% incl. Lötstopplack

TG-Wert: 150

Materialeigenschaft: CAF fest

Hersteller Leiterplatte: Panasonic

Oberfläche: chemisch Au

Anzahl Lagen: 4-lagig

Lagenaufbau: siehe Datei 002060000x\_lv0x-Lagenaufbau

Cu-Stärke: Aussenlage 35µm 100%

Innenlage 35µm 83%

Dicke Innenlage: 610µm (3x 7628)

Prepreq: 434µm (1x 7628 / 2 x 2116) siehe Datei 002060000x\_lv0x-Lagenaufbau

Lötstopplack: 25µm beidseitig bedeckt – Vias nicht geflutet

Kupferstärke Bohrung: 25µm

Bestückungsdruck unten: ja (Farbe weiß)

Kontur: gefräst gemäß Gerberdaten ±0,1mm